

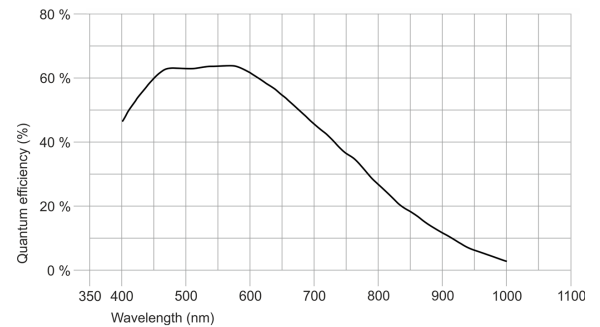
■ 신규 프로젝트에 부적합
이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 모노
셔터	Global Shutter
센서 특성	선형의
픽셀 등급	1.6 MP
해상도	1.57 Mpix
해상도 (h x v)	1448 x 1086 픽셀
종횡비	4:3
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	1/2.9"
광학 영역	4.996 mm x 3.747 mm
광학 센서 대각선	6.25 mm 1/2.9"
픽셀 크기	3.45 µm
CRA (주광선 각도)	0 °
제조사	Sony
센서 모델	IMX273LLR-C
게인(마스터/RGB)	24x/4x
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	256 / 8
AOI 이미지 높이/단차폭	2 / 2
AOI 위치 그리드(수평/수직)	4 / 2
수평 비닝	프레임 레이트 증가
수직 비닝	프레임 레이트 증가
비닝 방법	수평: 합산 / 수직: 합산
비닝 요소	2
수평 decimation (서브샘플링)	동일한 프레임 레이트
수직 decimation (서브샘플링)	프레임 레이트 증가
decimation (서브샘플링) 방법	M/C 자동



모델

픽셀 클럭 범위	25 MHz - 140 MHz
프레임 레이트 프리런 모드	73 fps
프레임 레이트 트리거(연속)	73 fps
프레임 레이트 트리거(최대)	77 fps
노출 시간(최소 - 최대)	0.025 ms - 999 ms
긴 노출(최대)	30000 ms
전력 소비	1.9 W - 3.2 W
이미지 메모리	128 MB
특별한 특징들	IDS 라인 스캔 모드 오버랩 트리거 센서 소스 게인 멀티 AOI

주변 조건들

아래 주어진 온도 값들은 카메라 하우징의 외부 장치 온도를 나타냅니다.

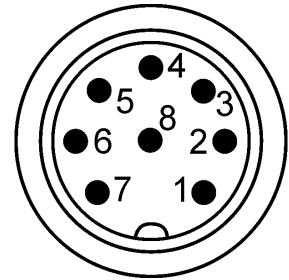
작동 중 허용되는 장치 온도	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
보관 중 허용되는 주변 온도	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
습도(상대, 비응축)	0 % - 100 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	GigE M12, 나사식
I/O 커넥터	8-핀 Binder 커넥터 (Binder series 712: 09-0427-020-08)
전력 공급	12 V - 24 V 또는 PoE

핀 할당 I/O 커넥터

1	옵토커플러 있는 트리거 입력 (+)
2	입력 전력 공급 장치 (VCC) 12-24V DC
3	범용 I/O (GPIO) 1
4	접지 (GND)
5	옵토커플러 있는 플래시 출력 (+)
6	옵토커플러 있는 플래시 출력 (-)
7	옵토커플러 있는 트리거 입력 (-)
8	범용 I/O (GPIO) 2



디자인

렌즈 마운트	C-마운트
IP 코드	IP65, IP67
치수 H/W/L	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
무게	173 g
하우징 자재	알루미늄

Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.

표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

이미지 획득

Freerun	✓
Software trigger	-
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	✓
Line scan	✓

기술적인 수정을 받아야 함 (2026-09-11)

2의 페이지 3

www.ids-imaging.kr

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

UI-5040FA-M-GL Rev.1.2 (AB12615)

깜박임	Flashing	-
	PWM flashing	-
이미지 조정	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
온보드 이미지 처리	Mirror/flip	-
	Pixel formats	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	(2,4)x(2,4)
	Binning (FPGA)	-
기타	Chunks	-
	Sequencer	-
	Firmware update	-
	1st supported firmware version	4.96.1